

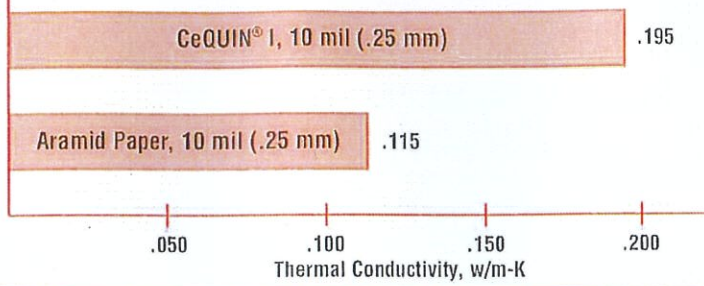
表1 標準特性

ASTM Test Method		CeQUIN® I						CeQUIN® II			
厚さ	mm	D-374	.13	.18	.25	.38	.63	.76	.76	1.0	1.5
	mil		5	7	10	15	25	30	30	40	60
引張り強度 MD	kN/m	D-828	1.0	1.6	2.1	2.8	3.5	4.0	8.9	9.6	10.6
	lb/inch		6	9	12	16	20	23	51	55	61
伸長率 MD	%	D-828	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
坪量	kg/m ²	D-202	.12	.18	.27	.41	.70	.80	.80	1.1	1.6
	lb/sq yd		.23	.34	.50	.76	1.3	1.5	1.5	2.1	3.0
絶縁破壊電圧	kV	D-149	1.0	1.3	1.8	2.6	3.2	3.8	6.5	8.8	9.2
吸湿率	%	D-644	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

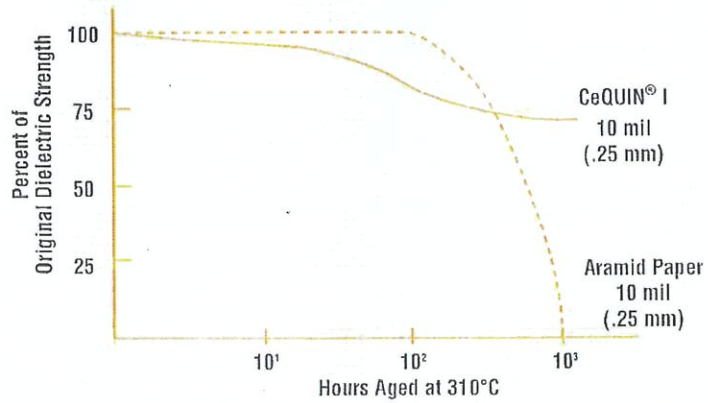
グラフ1
熱伝導率

CeQUIN I と光沢処理した
アラミド紙の熱伝導率比較

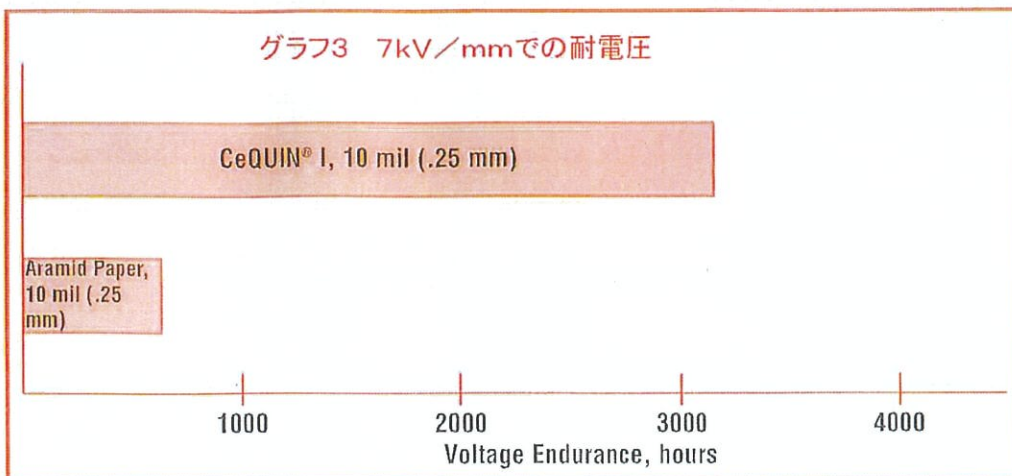
180°C per ASTM E 1530.



グラフ2
熱エージングによる絶縁強度
への影響



グラフ3 7kV/mmでの耐電圧



CeQUIN I と光沢処理アラミド紙の耐電圧の比較。各材料とも、5点のデータ平均値。
20°C 50%で同時にテスト